

- 오류정정 -

학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 30(1), 47 (2023)
논문제목	“FOWLP(Fan-out Wafer Level Packaging) 공정의 플라즈마 응용 기술”
요청부분	(pp.47) 참고문헌 권호, 페이지 누락 오류 32. J. H. Lau, “Recent Advances and Trends in Multiple System and Heterogeneous Integration with TSV-Less Interposers”, IEEE Trans. Compon. Packaging. Manuf. Technol. (2022).
정정	(pp.47) 참고문헌 권호, 페이지 누락 오류 정정 32. J. H. Lau, “Recent Advances and Trends in Multiple System and Heterogeneous Integration with TSV-Less Interposers”, IEEE Trans. Compon. Packaging. Manuf. Technol., 12(8), 1271-1281 (2022).
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 30(1), 94 (2023)
논문제목	“전기영동증착법으로 폴리이미드를 코팅한 탄소섬유의 발열 특성 연구”
요청부분	(pp.94) 참고문헌 페이지 표기 오류 10. A. Fosbury, S. Wang, Y. F. Pin, and D. D. L. Chung, “The interlaminar interface of a carbon fiber Polymer-matrix composite as a resistance heating element”, Compos. Pt. A-Appl. Sci. Manuf. 34(10), 993-940 (2003)
정정	(pp.94) 참고문헌 페이지 표기 오류 정정 10. A. Fosbury, S. Wang, Y. F. Pin, and D. D. L. Chung, “The interlaminar interface of a carbon fiber Polymer-matrix composite as a resistance heating element”, Compos. Pt. A-Appl. Sci. Manuf., 34(10), 933-940 (2003)